

第22回食品ハイドロコロイドシンポジウム

主催：食品ハイドロコロイド研究会

協賛：化学工学会、高分子学会、セルロース学会、日本栄養・食糧学会、日本応用糖質科学会、日本家政学会、日本化学会、日本官能評価学会、日本こんにやく協会、日本材料学会、日本食品化学学会、日本食品機械研究会、日本食品科学工学会、日本食品工学会、日本食品添加物協会、日本食物繊維学会、日本水産学会、日本生化学会、日本生物工学会、日本咀嚼学会、日本調理科学会、日本熱測定学会、日本農芸化学会、日本バイオレオロジー学会、日本物理学会、日本油化学会、日本レオロジー学会、バイオインダストリー協会（50音順・依頼中）

日時：2011年5月18日(水) 10:10-17:00（受付は10:00から開始します）

会場：大阪市立大学文化交流センター（大阪市北区梅田1-2-2-600(大阪駅前第2ビル6階)）
（地図・交通案内等：<http://www.osaka-cu.ac.jp/info/commons/access-umeda.html>）

(プログラム)

10:10-10:50	X線散乱法による多糖類ゲルの構造解析	大阪電通大工	湯口 宜明
10:50-11:30	果実セルロースのナノファイバー	東大農	空閑 重則
11:30-12:00	卵白タンパク質の加熱変性	キューピー(株)	半田 明弘
12:00-13:10	昼休み		
13:10-13:50	タンパク質の熱分析	長岡技科大生物	城所 俊一
13:50-14:30	粒度感・ざらつき	聖徳大	今井 悦子
14:30-15:00	デザートの新規積層化技術	雪印メグミルク(株)	郷田 雅之
15:00-15:10	休憩		
15:10-15:50	嚥下障害	浜松リハ病院	藤島 一郎
15:50-16:30	食品表示と食品の安全・安心	実践女子大	田島 眞
16:30-16:55	総合討論		
17:15-19:15	懇親会		

定員：95名(申込先着順)

申込方法：web上(<http://food.hydrocolloids.org/sympo/>)から必要事項をご記入の上お申し込みください。

参加費：食品ハイドロコロイド研究会会員:5000円(学生会員1000円)

非会員：一般 8000円、大学・官公庁 6000円、学生 3000円

懇親会費：5000円

支払方法：申込受理後、eメールにて通知。

事務局：〒558-8585 大阪市住吉区杉本3-3-138 大阪市立大学大学院生活科学研究科内

食品ハイドロコロイド研究会 世話人 西成勝好

e-mail: sympo@food.hydrocolloids.org

<http://food.hydrocolloids.org/>